

株式会社ジェイ・イー・ティ

2023年12月期  
決算説明会資料

2024年3月4日

- 1.会社概要**
- 2.2023年12月期決算概況とトピックス**
- 3.2024年12月期決算予想**
- 4.今後の成長戦略**  
**Challenge 2026骨子**

## Appendix



A detailed, stylized illustration of a blue circuit board with various components and traces, serving as a background for the slide.

# 1. 会社概要

# 会社概要

半導体洗浄装置の開発・製造・販売・アフターサービスを展開

JET

リーマン・ショック後の半導体不況時に民事再生手続を開始し、その後破産手続に移行したエス・イー・エス(株)が前身  
**同社の卓越した半導体洗浄装置に関する技術を継承すべく、**  
販売代理店であった韓国企業のZEUS CO., LTD. (以下、「ZEUS」)の全額出資のもと、  
2009.4.24に設立、2009.5に**エス・イー・エス(株)の岡山工場等を事業譲渡により引き継ぎ誕生**

## ■会社概要

会社名 株式会社ジェイ・イー・ティ

英訳名 J.E.T. Co., LTD.

設立 2009年4月

資本金 1,848百万円 (2023年12月31日時点)

所在地 岡山県浅口郡里庄町新庄金山6078番  
TEL 0865-69-4080

代表者 代表取締役社長 房野 正幸

従業員数 **165名**  
**289名 ※連結会社含む全従業員数**  
**(2023年12月31日時点)**

事業内容 半導体洗浄装置の開発・製造・販売・  
アフターサービス等



BW3000  
バッチ式

BW3700  
バッチ式



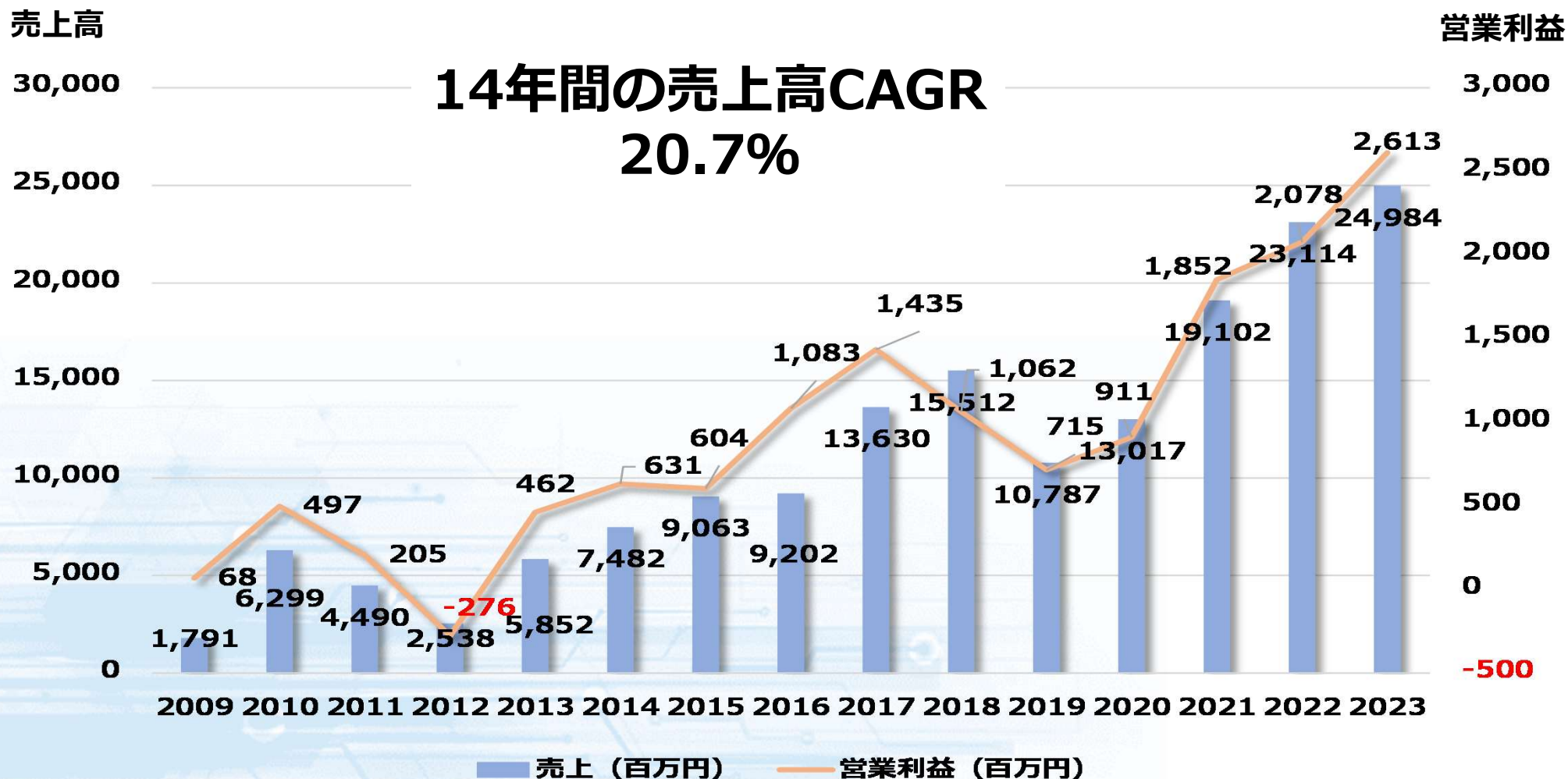
HTS-300  
枚葉式



# 連結長期業績（売上高・営業利益）推移

シリコンサイクルの影響は受けるものの、**半導体需要の増加に伴い成長**

売上高は2009年17億91百万円から2023年249億84百万円に成長（年平均成長率CAGR20.7%）



\* 2019年以前の数字は監査法人による監査を受けていない参考数字

# グループ関係図

親会社ZEUSとは事業の棲み分けがなされ、競合関係もなく、経営についても役職員の出向等の受け入れを廃止し独立性の確保を図る



所在地： 大韓民国  
京畿道華城市

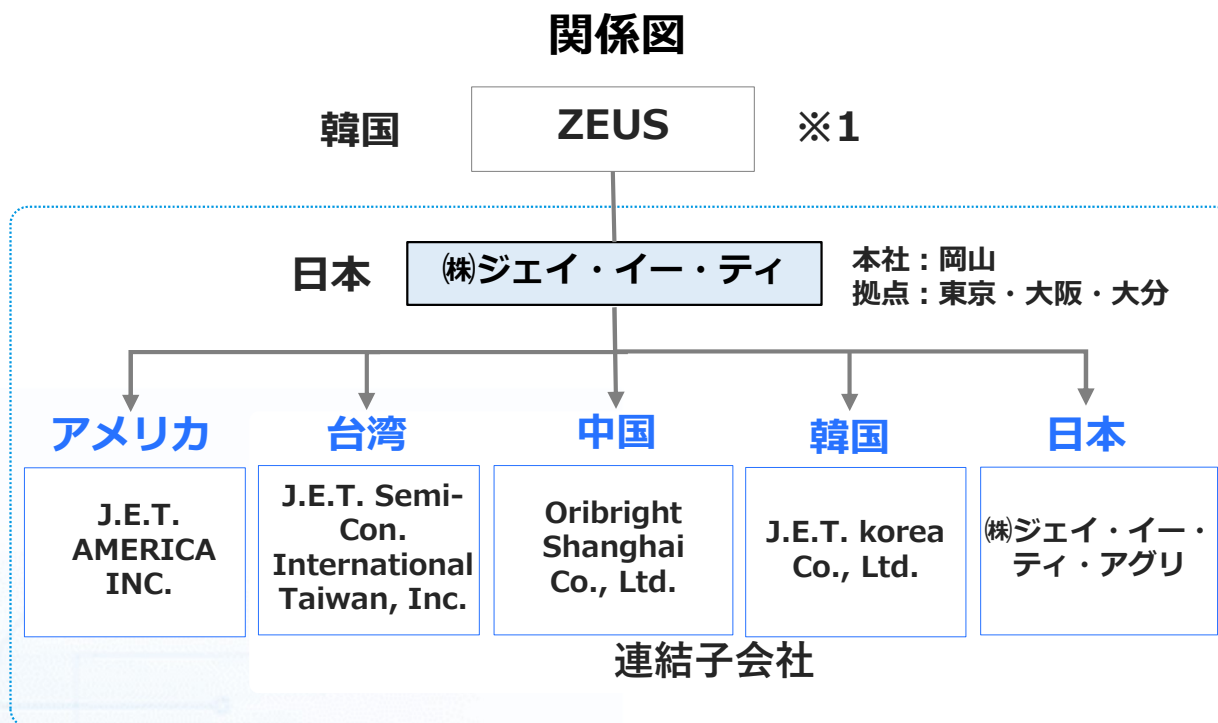
資本金： 5,192百万KRW

事業の内容： 半導体・液晶用各種製造装置の製造・販売

当社の議決権の  
保有割合(%)： 66.4% (直接)

関連当事者  
との関係： 営業取引

取引の内容： 双方より部品・材料等の販売・仕入及び  
装置製造業務委託、  
当社よりZEUSへ販売手数料支払い等



※1 韓国取引所KOSDAQに上場

\* 2022年4月末までは、当社にてZEUSより非常勤取締役1名を受け入れていたが、2022年5月以降、ZEUSから当社への役職員の出向等による受け入れは行っていない。



# 拠点

前身エス・イー・エス(株)時代からのアジア展開を更に**意識的に加速**、  
**韓国・台湾・中国を中心に拠点網を展開**  
**2023年10月 米国にも拠点設立**

■ 国内拠点  
 ■ 海外拠点



JET AMERICA INC.

**米国拠点  
3名**

**韓国拠点  
19名**



J.E.T. Korea Co., Ltd.

- Oribright Shanghai Co., Ltd. 北京事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 無錫事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 合肥事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 西安事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 広州事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 上海本社

九州出張所(※1)

大阪事務所(※2)

東京事務所(※1)

(株)ジェイ・イー・ティ

- 本社
- 笠岡ファーム(※3)

**本社 (岡山)**



**中国拠点 79名**

\* 中国拠点については、一部の事務所の掲載を省略しております。

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.  
 (HEAD Office) 台湾本社



**台湾拠点  
24名**

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.  
 (Singapore branch) シンガポール支社

**シンガポール 3名**

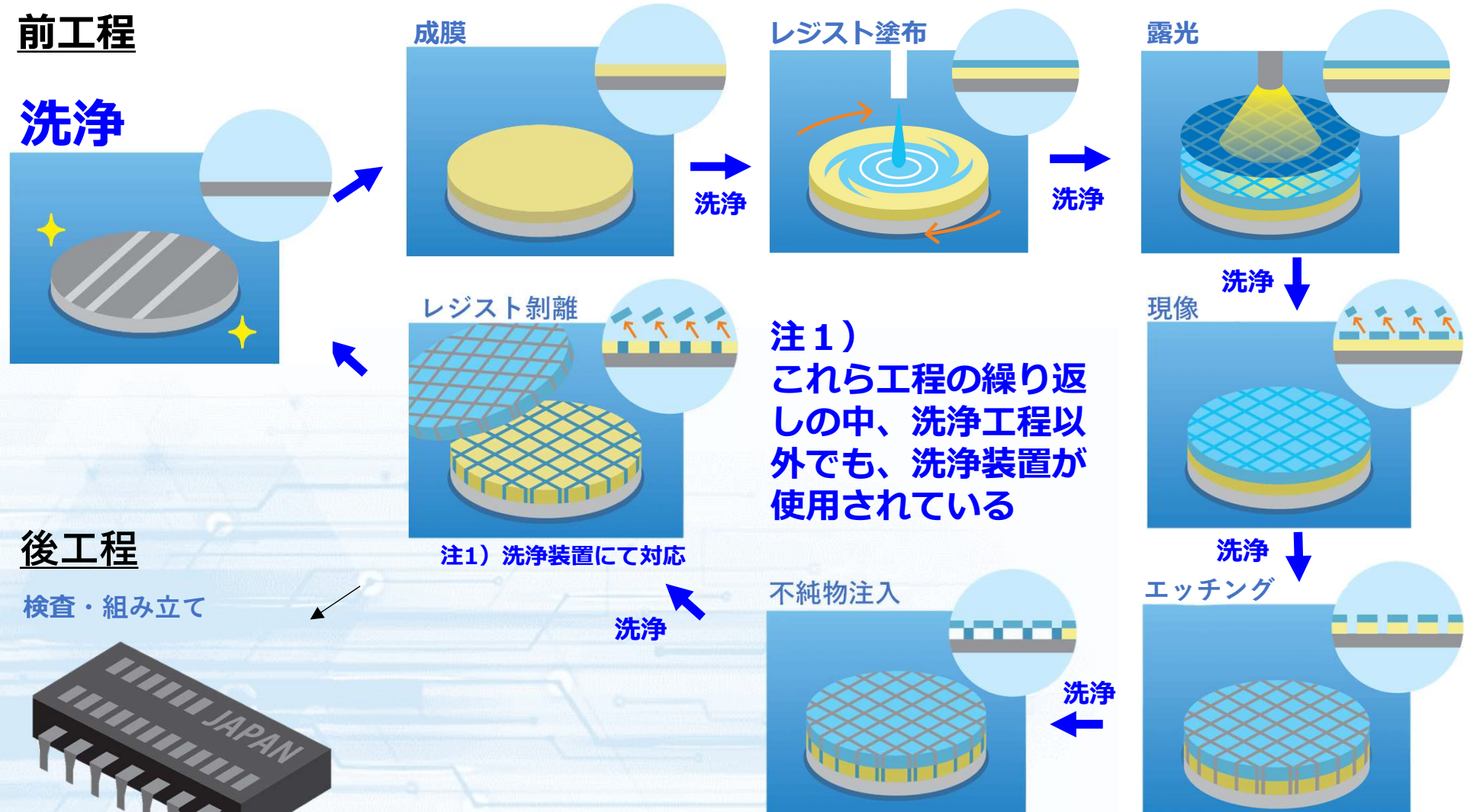
- ※1 東京事務所及び九州出張所では、当社顧客へのフィールドサービスを提供しております。
- ※2 大阪事務所では、LIB製品の営業を行っております。
- ※3 笠岡ファームでは、当社連結子会社である(株)ジェイ・イー・ティ・アグリがトマトを栽培しております。

# 半導体製造プロセス 前工程

半導体製造プロセス前工程（500工程以上）において、洗浄は極めて重要な工程  
前工程の30~40%（工程数ベース）が洗浄装置を使用する工程と考えられている

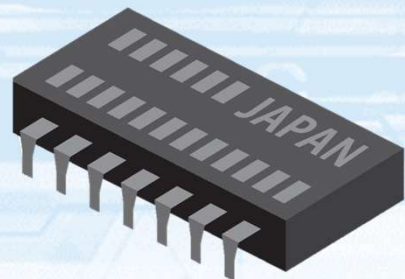
## 前工程

### 洗浄



## 後工程

検査・組み立て





# 半導体洗浄装置 バッチ式と枚葉式：当社製品の特徴

洗浄には薬液を使用するウェット洗浄と酸素ガスやオゾンを用いるドライ洗浄の2種類が存在  
より多く使われているのはウェット洗浄。ウェット洗浄にはバッチ式と枚葉式が存在

	バッチ式洗浄装置	枚葉式洗浄装置
概要	25~50枚のウエハをまとめて各処理槽にて処理する洗浄装置	ウエハを1枚ずつ処理槽内で処理する洗浄装置
長所	生産性が高い	1枚ずつ精密に制御した洗浄が可能
短所	ウエハの塵を拾い易い	生産性が落ちる
現状	一時期、枚葉式に置き換わるも、生産性の優位性から一定のシェアを堅持	現在の主要洗浄装置
当社製品の特徴	他社の標準化された製品と比較し、カスタマイズ性に優れ、洗浄槽の構成や設置数の変更が可能 F-Typeには唯一当社が対応	ヒーターでウエハ上の薬液を高温にするといった特殊な機能を搭載、処理性能を向上させ使用薬液量も削減 高温・高粘度処理に優位性を持つ

\* 当社独自の認識による。

# 競合状況と差別化要素① 競合先

半導体洗浄装置は、2000年代以降日本企業が70%以上のシェアを持つと考えられており、特にA社、B社の存在感が大きい

	概要	取扱製品の特徴	競合状況の分析
A社	半導体洗浄装置につき 世界トップシェア	枚葉式・バッチ式洗浄装置 共に世界トップシェア 標準化された装置に強み	半導体洗浄業界の最大手 標準化装置に強みを持つが、 当社主力ユーザーでの 競合は少ない
B社	半導体製造装置につき 世界トップレベルのシェア	半導体前工程で使用される装置 (WFE) 全体で世界トップレベルの シェア 枚葉式・バッチ式とも 高い技術力を持つ	主力ユーザーに対し、売り込み を強化しており、競合は発生 ただし、 機能による差別化が図れている
当社	韓国・中国・台湾を主体に 営業展開 ここ数年は中国市場に注力	バッチ式洗浄装置を得意とし、 連結売上の90%以上がバッチ式 加えて、 特殊な枚葉式洗浄装置にも強み	

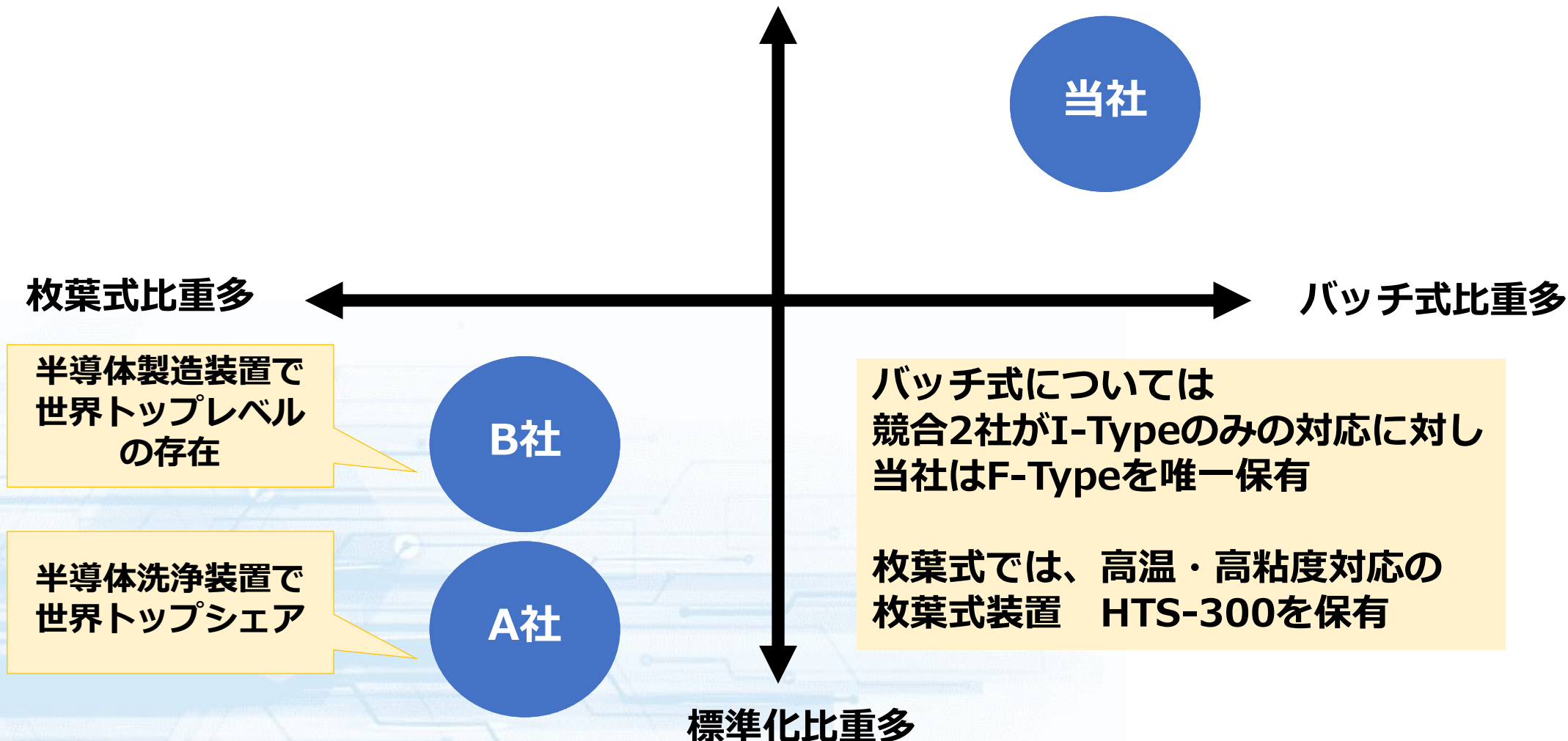
\* 上表の競合先及び当社に関する説明は、2023年12月時点での当社独自の認識による。



## 競合状況と差別化要素② ポジショニング

A社、B社の存在感は大きいですが、当社も市場で独自の立ち位置を占める

ニッチ対応多・カスタマイズ性多



注) 当社独自の認識に基づくイメージ図である。バッチ式推定世界シェアはSEMI販売統計、競合各社決算説明資料より当社推計 ©J.E.T CO.,LTD. All rights reserved

# 当社の特長と強み 5つのポイント

# 1

長い歴史に培われた  
海外大手顧客との信頼関係

# 2

アジア特化戦略により築いた  
アジアでのポジション・人脈

# 3

小回りの利く体制  
柔軟性・機動力  
カスタマイズ対応力

# 4

自動車・電機  
日本の産業の裾野の広さが  
育んだ優秀な  
外注先（協力会社）の活用

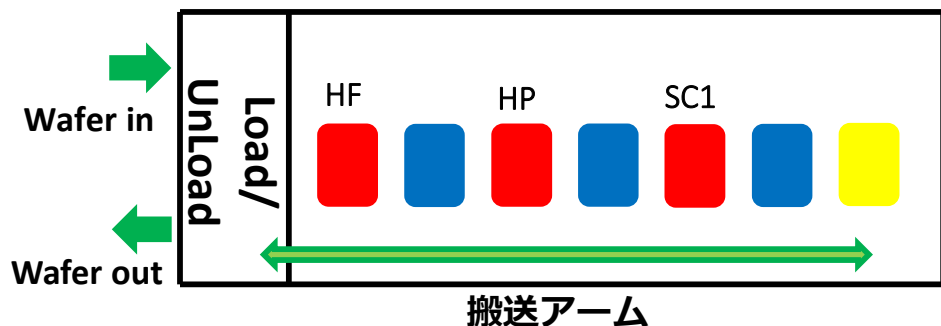
# 5

特定領域  
(高温・高粘度薬液対応等)  
での差別化された技術力  
経験知の蓄積



# JETバッチ装置の優位性 → 唯一F-Typeを持つ

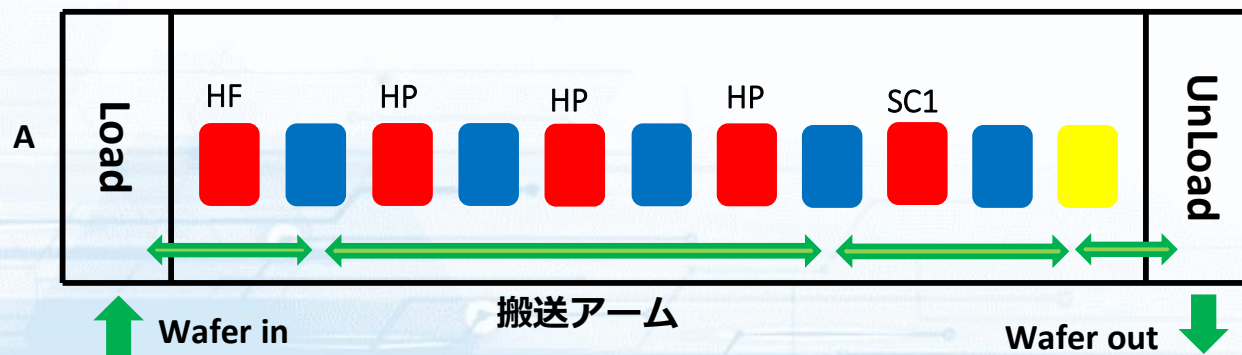
## I-Type A社 / B社 / 当社



### 特徴

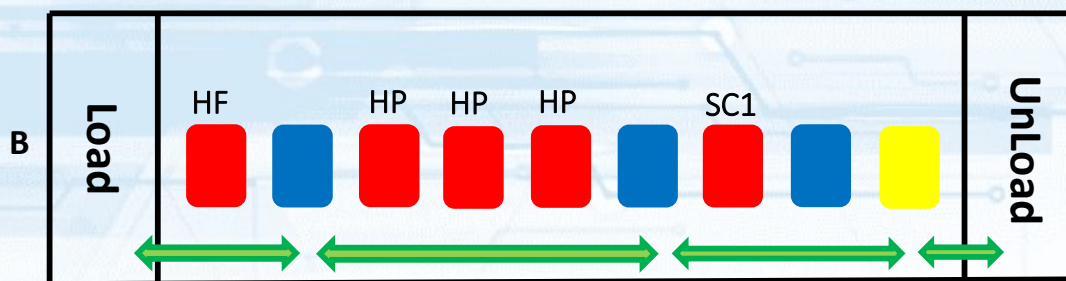
- コンパクト
- 処理槽 MAX 8 槽  
(アームが左右に動き、渋滞が発生する為)
- スループット 最大250w/h

## F-Type 当社のみ



### 特徴

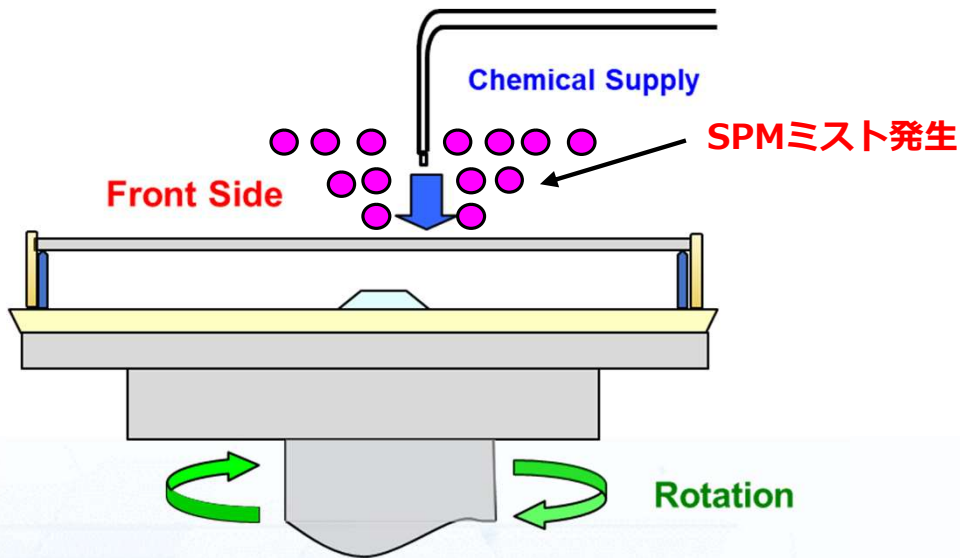
- 少し大きい
- 処理槽 MAX14槽  
(アームが一方通行で、渋滞なしの為)
- A/B 選択可能
- Bはケミカル槽を連続配置可能
- 高温の硫酸・リン酸洗浄に多用
- **スループット 最大 500w/h**



\* 2023年12月時点での当社独自の認識による。

# 当社 枚葉式装置の優位性

## A/B社 枚葉式SPM装置



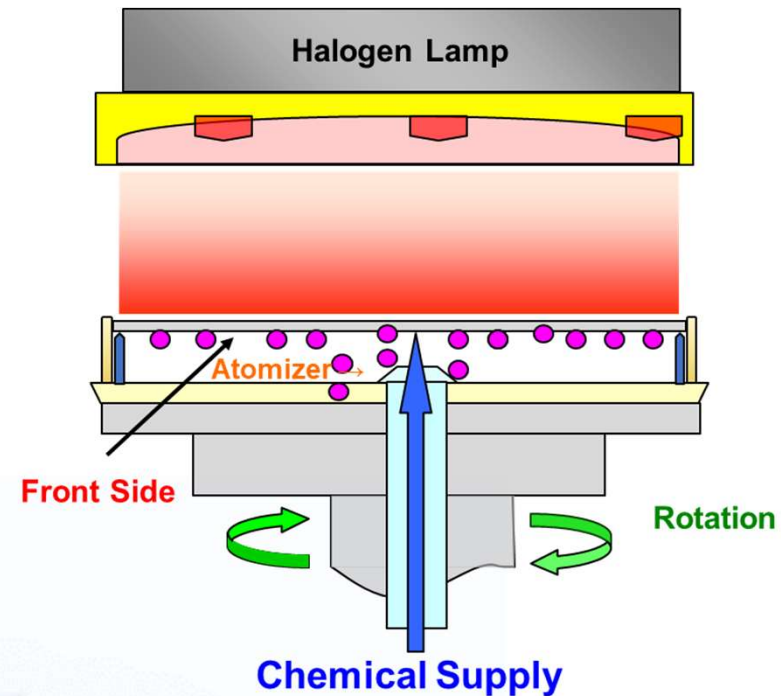
### 特徴

- 処理温度：150~200℃
- ケミカルの反応熱を利用
  - ➡ケミカルをかけ続けるも、高温維持は難しい
- プロセス時間：5min/HDIレジストウエハ (注)
- ➡必要ケミカル量：3000ml/ウエハ  
(5分間ケミカルをかけ続ける必要がある為)
- SPMミストによりパーティクル発生量が多い

\* HDIレジストウエハ=硬化層付きのレジストウエハ

\* 2023年12月時点での当社独自の認識による。

## 当社 枚葉式SPM装置 (HTS-300)



### 特徴

- 処理温度：200~240℃
- ヒーターにて高温維持可能
- 処理面を反転し、霧状にしたケミカルを使用
- **プロセス時間：0.5min/HDIレジストウエハ**
  - ➡**必要ケミカル量：150ml/ウエハ**
- SPMミストが拡散せず、パーティクルの発生量が少ない



A detailed, stylized illustration of a blue circuit board with various traces, pads, and components, serving as a background for the slide.

## 2. 2023年12月期決算概況と トピックス

# 業績サマリー

一部、洗浄装置立上遅延の影響を受けるも、洗浄装置販売は順調  
4期連続で増収増益を達成

売上高  
24,984百万円

前期比 +8.1%

営業利益  
2,613百万円

前期比 +25.7%

経常利益  
2,444百万円

前期比 +28.9%

当期純利益  
1,651百万円

前期比 +37.9%

- ✓ 地政学的なリスクやインフレの影響を受けた世界的な消費減速の影響でメモリ価格下落続くも、DRAMは生成AI向けサーバー需要などから価格上昇新たな設備投資も始まる
- ✓ 中国を中心とした成熟世代半導体向け設備投資は継続も、一部に投資減速の傾向

単位 (百万円)	2022年12月期	売上比 (%)	2023年12月期	売上比 (%)	対前年増減率 (%)
売上高	23,114	—	24,984	—	8.1%
売上総利益	4,893	21.2%	5,535	22.2%	13.1%
販管費	2,815	12.2%	2,921	11.7%	3.8%
営業利益	2,078	9.0%	2,613	10.5%	25.7%
経常利益	1,896	8.2%	2,444	9.8%	28.9%
当期純利益	1,197	5.2%	1,651	6.6%	37.9%

単位 (百万円)	2022年12月期	2023年12月期
設備投資額	50	41
減価償却費	325	65
研究開発費	513	739

\* 減価償却費のうち研究開発に伴う費用は研究開発費として記載



# 連結貸借対照表

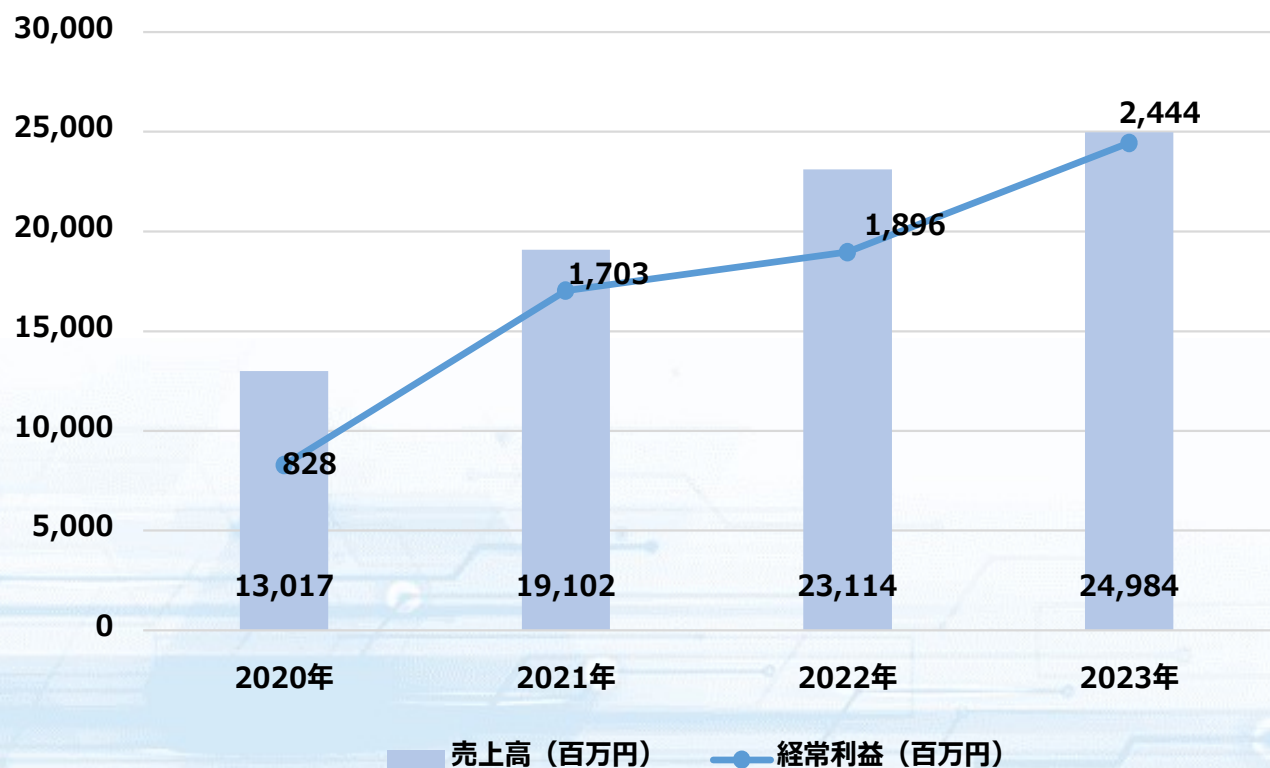
単位（百万円）	2022年12月期	2023年12月期	増減	主な増減要因
流動資産	26,439	27,068	△629	
有形固定資産	1,137	954	▼183	
無形固定資産	75	56	▼19	
投資その他資産	639	695	△56	
資産合計	28,290	28,774	△484	
流動負債	14,435	11,496	▼2,939	短期借入金の減少
固定負債	5,514	4,866	▼648	長期借入金の減少
負債合計	19,950	16,362	▼3,588	
純資産合計	8,340	12,411	△4,071	増資による資本金、資本剰余金の増加 利益剰余金の増加
負債純資産合計	28,290	28,774	△484	

# 売上高・経常利益推移

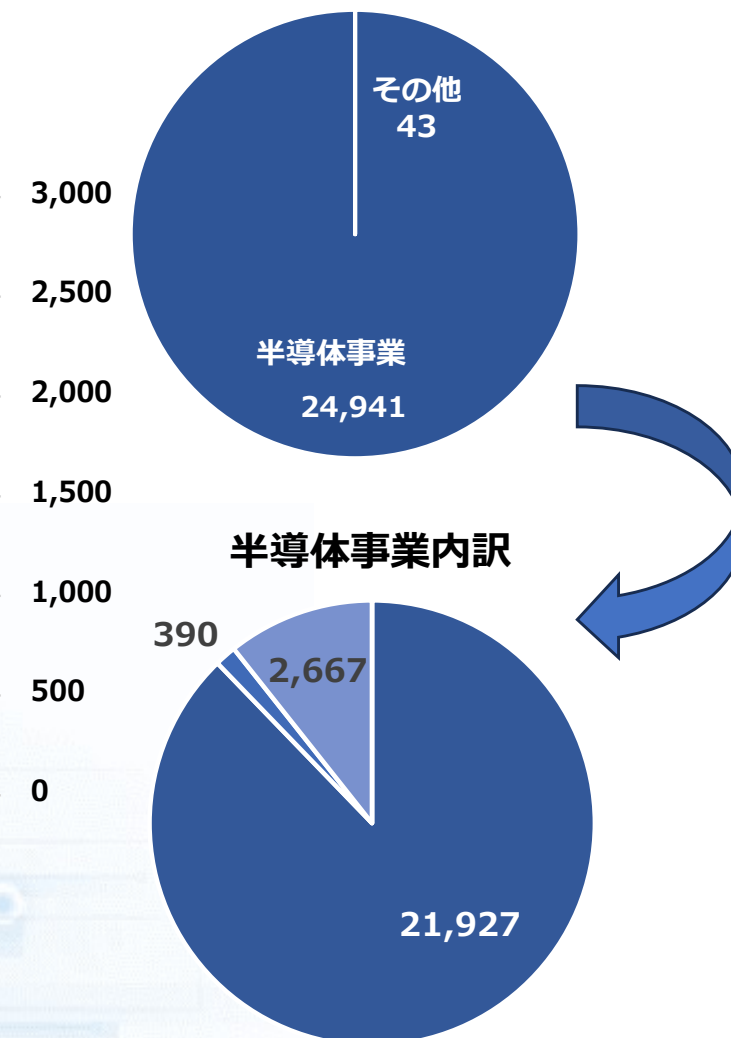
# 売上構成

4期連続で最高益を更新中

## 売上高・経常利益推移



## セグメント別連結売上高

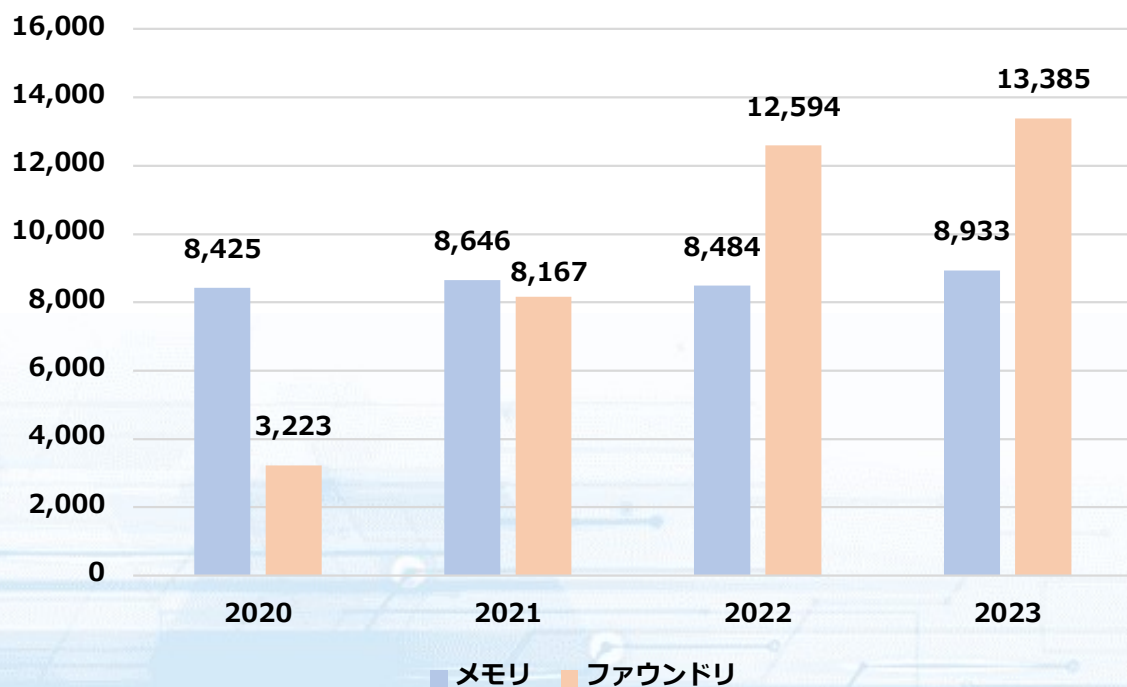


■ バッチ式 ■ 枚葉式 ■ フィールドサービス ■ その他

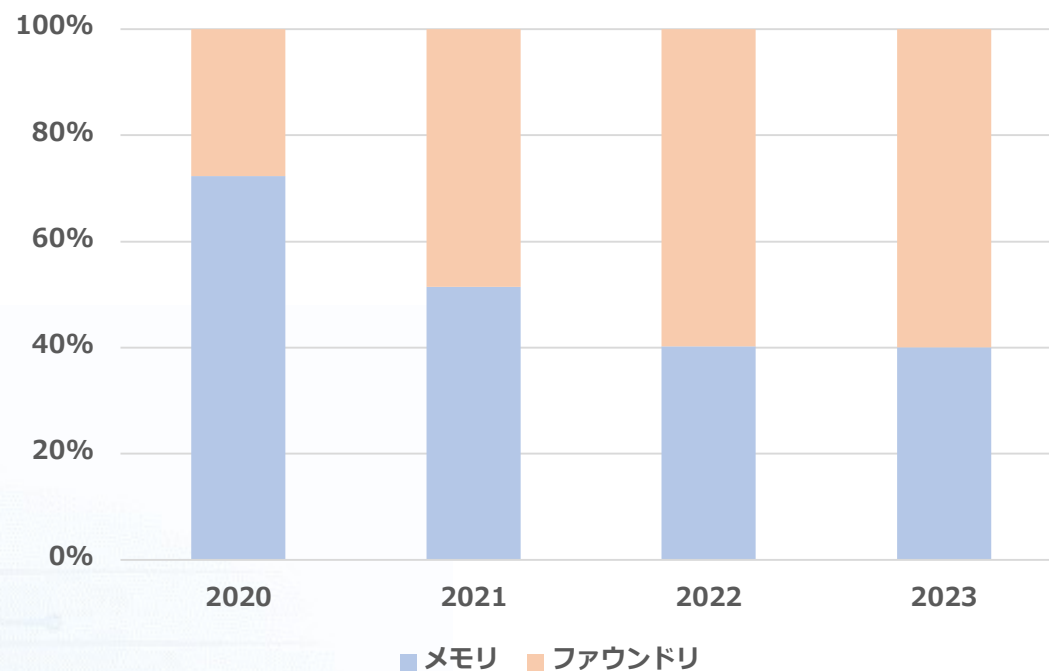
# 装置売上高推移（仕向け先別）

足元ではファウンドリ向けの構成比が上昇

## 装置売上高仕向け先別推移



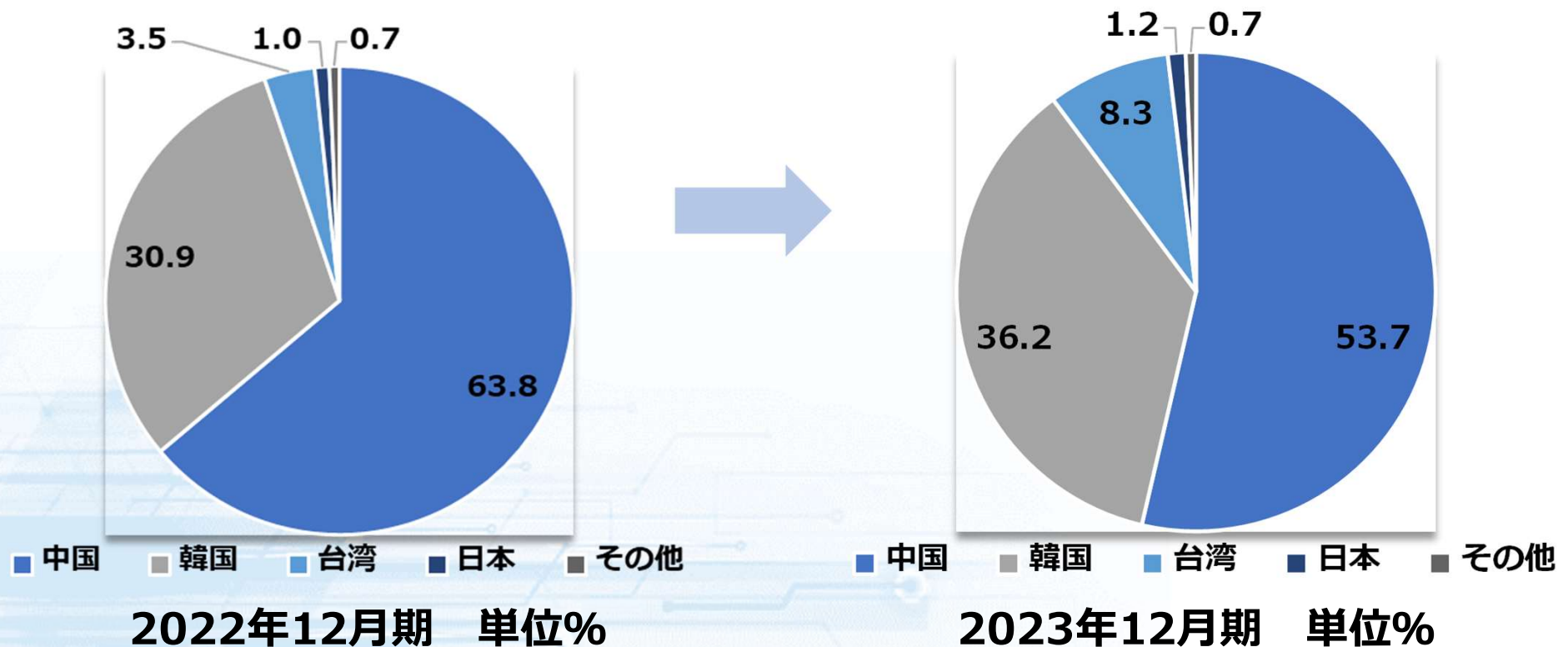
## 装置売上高仕向け先別構成比推移



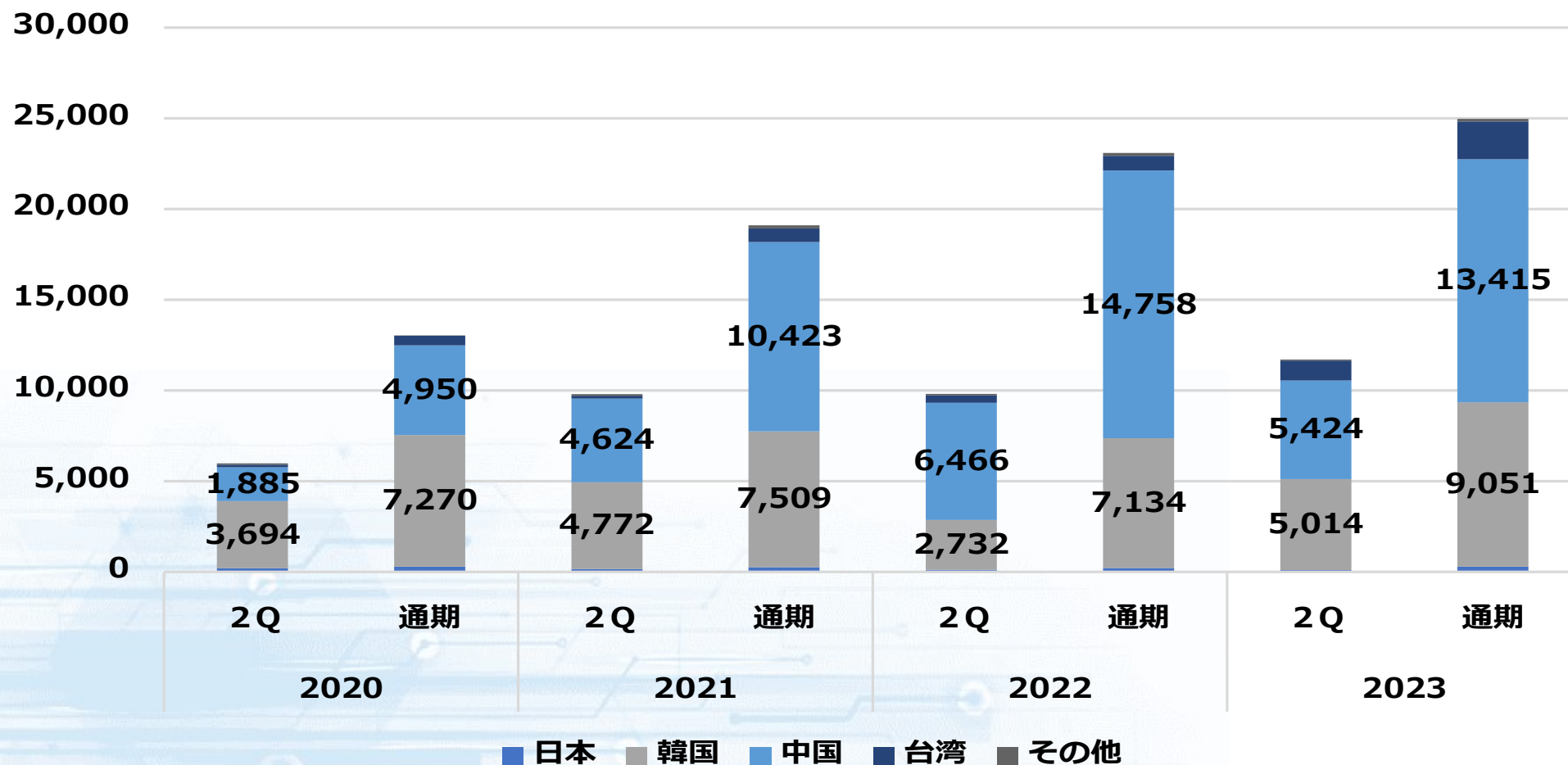


# 地域別売上高構成比推移① 前期比較

前期に比べ中国の構成比が減少し、韓国・台湾の構成比が上昇  
将来的には中国・台湾、韓国、米国、日本でそれぞれ25%の構成比を目指す



# 地域別売上高構成比推移②



# トピックス① 米国子会社 (JET AMERICA INC.)

米国半導体産業の集積地であり、多額の設備投資が予定されているテキサス州ダラスに10月、半導体製造設備装置の販売・メンテナンス会社を設立、2024年1月より事業開始

テキサス州は、米国半導体開発・製造の大手  
テキサス・インスツルメンツ (TI) の拠点  
本社はダラス アナログICの最大手企業

地政学的要因を背景にCHIPS法など  
半導体産業の振興に注力する米国政府の方針も  
あり、今後大きな投資が予定されている

米国子会社は  
レガシー領域での顧客獲得にも注力



ダラス

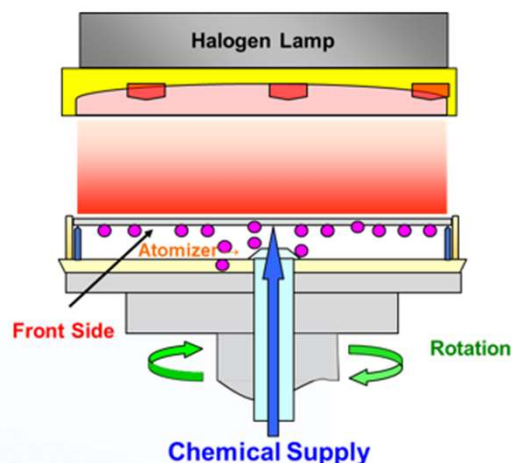
テイラー

オースティン



## トピックス② Rapidus社からの開発業務受託

2020年代後半に2nm以下のロジック半導体の開発・量産を目指すRapidus社から枚葉式半導体洗浄装置の開発業務を受託



ご参考：当社枚葉式装置



HTS-300



Rapidus千歳工場  
2023年9月起工  
2025年4月頃の稼働を予定

### Rapidus社 概要

所在地：東京都千代田区麴町4-1  
麴町ダイヤモンドビル11階

代表者：代表取締役社長 小池淳義

事業内容：半導体素子、集積回路等の電子部品の研究、  
開発、設計、製造及び販売

資本金：73億4,600万円

設立年月日：2022年8月10日

A detailed, stylized illustration of a blue circuit board with various traces, components, and a small bar chart-like pattern in the lower right quadrant.

### 3. 2024年12月期決算予想

- ✓ 欧米の利上げやインフレは落ち着きつつあるも、引き続き地政学的なリスクなど不透明要因は多い市場環境
- ✓ DRAM価格は上昇に転じ、NANDフラッシュも最悪期は離脱  
生成AI向けにデータセンタ投資やPC、スマートフォンでも新たな需要を見込む
- ✓ DRAMの高容量化、NANDフラッシュの高層化等に取り組む韓国メーカーには米国市場等でのサービス体制の構築、新たな洗浄装置の提案に努める
- ✓ 新たに設立した米国子会社（JET AMERICA INC.）にて、米国市場での新規顧客開拓に着手する
- ✓ 日本市場では最先端プロセスへの対応に加え、車載向けパワー半導体向け等で新規顧客の開拓に努める



# 通期決算予想

## 5期連続増収増益の達成を目指す

単位 (百万円)	2023年12月期	売上比 (%)	2024年12月期	売上比 (%)	対前年増減率 (%)
売上高	24,984	—	25,680	—	2.7%
売上総利益	19,449	77.8%	19,650	76.5%	1.0%
販管費	2,921	11.7%	3,290	12.8%	12.6%
営業利益	2,613	10.5%	2,740	10.7%	4.8%
経常利益	2,444	9.8%	2,600	10.1%	6.3%
当期純利益	1,651	6.6%	1,740	6.8%	5.3%

単位 (百万円)	2023年12月期 (実績)	2024年12月期 (予定)
設備投資額	41	157
減価償却費	65	76
研究開発費	739	719

\* 減価償却費のうち研究開発に伴う費用は研究開発費として記載

A detailed, stylized illustration of a blue circuit board with various components and traces, serving as a background for the slide.

## 4. 今後の成長戦略 Challenge2026 骨子

# 今後のビジネス展開の方向性

1. **安定・継続した成長の実現と利益率の改善**
2. **差別化された装置の開発による競争優位の実現**
3. **需要の増減に対応できる生産体制の構築**
4. **北米及び日本での新たな市場開拓**



## 当面の計数目標

利益率の向上が当面の最優先目標  
受注残を消化し、リードタイムの正常化を待って  
**利益率15%の早期達成**を目指す

売上高249億円  
営業利益26億円  
営業利益率  
10.4%  
2023年12月期



売上高300億円  
営業利益45億円  
営業利益率15%

2027年までに  
達成

達成

2027年までに

# Challenge 2026

目標達成に向けて、現行の中期経営計画を見直し、新たな中期3ヶ年計画を策定  
4つの軸で戦略を検討



## 新HTS

1. 硫酸以外のプロセス対応
2. 薬液（プロセス）別製品型式対応
3. リン酸は日本で実績を → 横展開
4. 03は台湾で実績を → 横展開



HTS-300

## BW3500

1. 2024年7月上市予定
2. 中国市場での他社装置切り替えの戦略機種 → 他地域へ横展開

## SiC対応装置

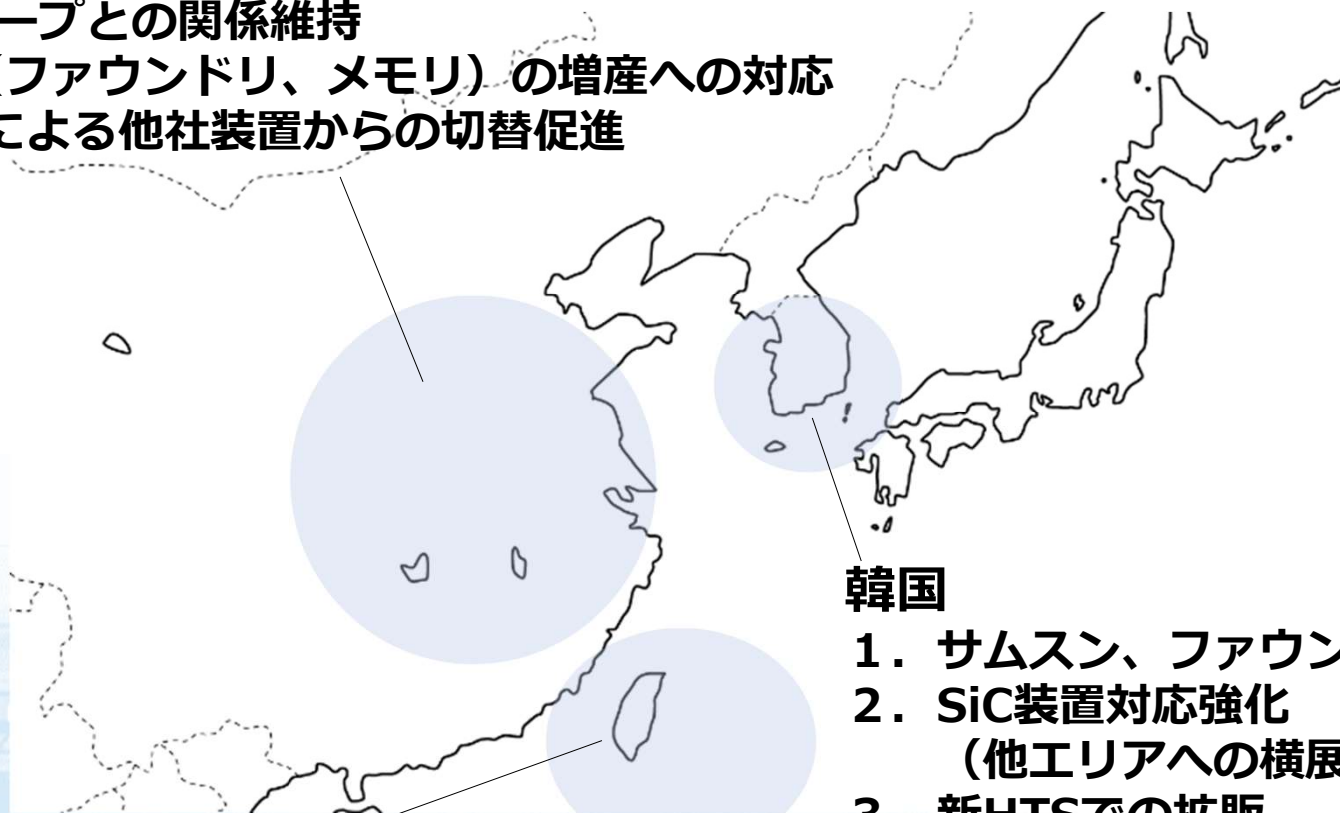
1. サムスン電子向けにて実績を → 横展開



# エリア戦略① 韓国・中国・台湾 主要市場

## 中国

1. SMICグループとの関係維持
2. 既存顧客（ファウンドリ、メモリ）の増産への対応
3. BW3500による他社装置からの切替促進



## 韓国

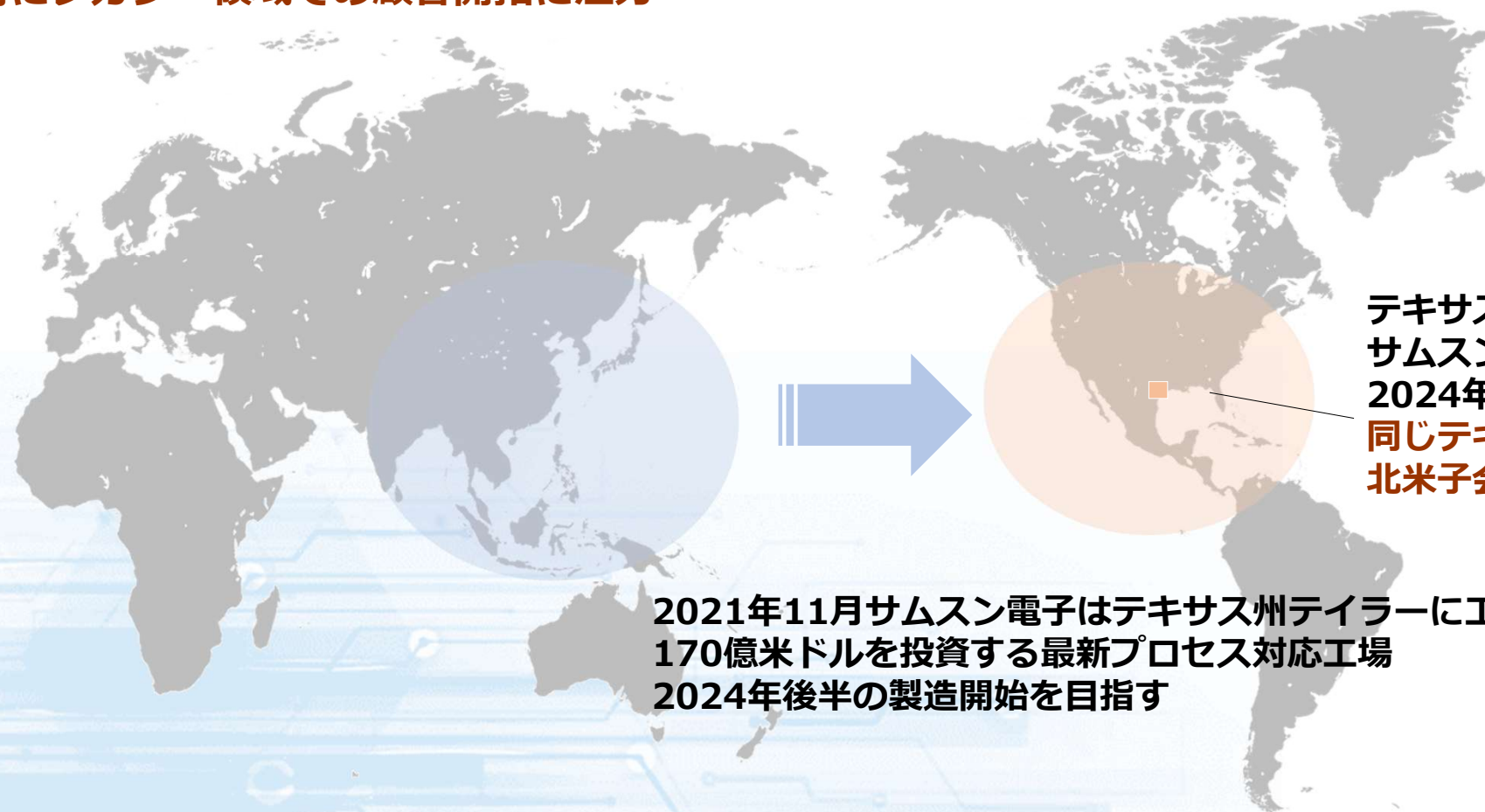
1. サムスン、ファウンドリでの拡販
2. SiC装置対応強化  
（他エリアへの横展開）
3. 新HTSでの拡販

## 台湾

1. HTS/03の対応を優先  
（他エリアへの横展開）
2. 既存顧客との関係維持
3. BW3500 による他社装置からの切替促進

## エリア戦略② 北米での市場開拓

2024年稼働予定のサムスン電子テキサス・テイラー工場向け洗浄装置を既に受注  
この受注を足掛かりに**2023年10月拠点を開設**、北米での顧客開拓を進める  
特に**レガシー領域での顧客開拓に注力**



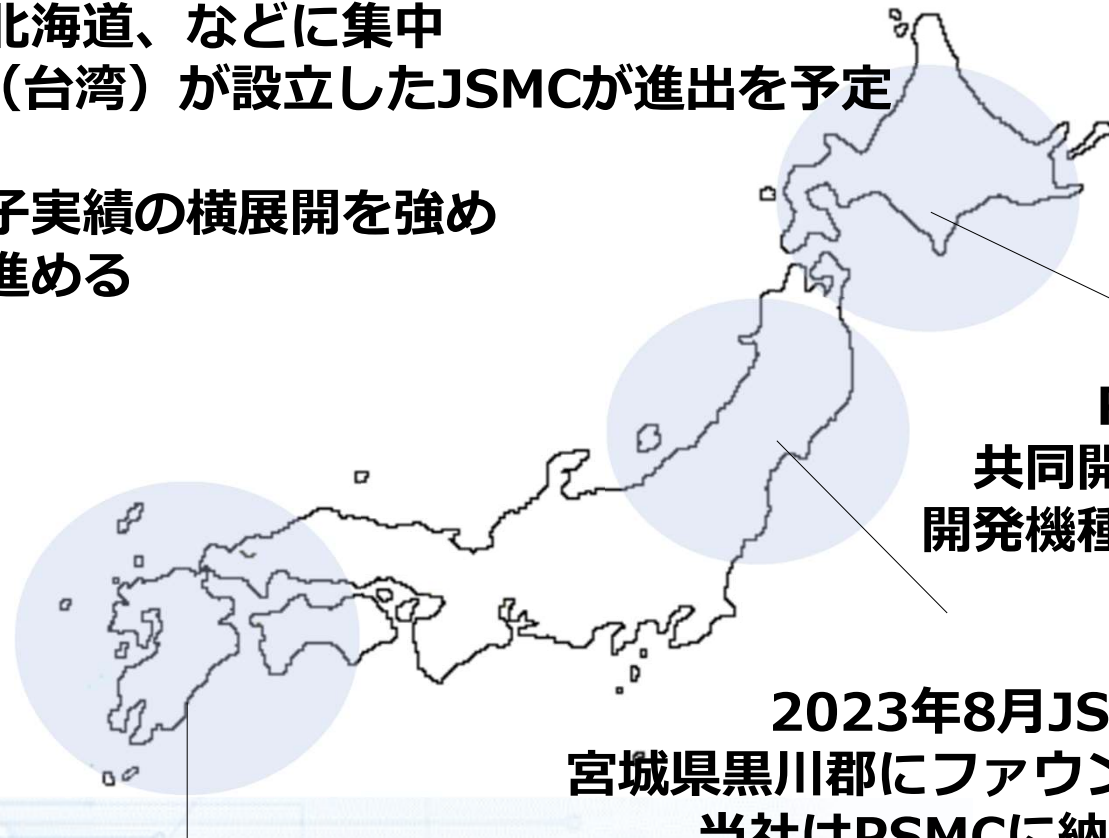
テキサス州  
サムスン電子 テイラー工場  
2024年稼働予定  
同じテキサス州ダラスに  
北米子会社設立

2021年11月サムスン電子はテキサス州テイラーに工場建設を表明  
170億米ドルを投資する最新プロセス対応工場  
2024年後半の製造開始を目指す

## エリア戦略③ 日本での市場開拓

地政学的な要因や政府の政策的挺入れもあり、  
半導体関連投資が九州、北海道、などに集中  
宮城県ではSBI・PSMC（台湾）が設立したJSMCが進出を予定

好機を逃さずサムスン電子実績の横展開を強め  
国内メモリ顧客の開拓を進める



枚葉式  
Rapidus  
共同開発案件進行中  
開発機種横展開も模索

2023年8月JSMC設立  
宮城県黒川郡にファウンドリ建設を予定  
当社はPSMCに納入実績あり

様々な半導体関係の投資案件が集中  
車載及びパワー半導体向け顧客の開拓に注力



## SD（システムデザイン部）新設

仕様から顧客ニーズを確認し、メーカー提案型にて仕様を検討  
効率的な製造（設計段階からの見直し）によるコストダウンを目指す

## 営業強化

1. JET Americaを通じたアメリカ市場への参入
2. 日本市場対応の営業部門新設

## サプライチェーン強化

1. 架台、石英部材、電気配線などボトルネック解消のための強化を図る
2. ユニット製作外注の増強
3. **そのためのM&Aの検討（部材、装置メーカー、設計会社、販社等）**

## 新工場の建設

1. 既存工場との棲み分け、新Visionに対応した新工場建設を検討
2. 新HTSへの対応、R&Dの強化などを図る
3. 大幅な生産効率化の実現（自動化導入など）
4. 環境対策に対応

## 製造戦略② 新工場建設

本社（岡山県里庄）近接の浅口市に2027年稼働の新工場（2.5ha）を建設予定  
本年度は用地取得とコンセプトの検討を予定



本社（里庄）







完成予想図



A dark blue rectangular box containing the word 'Appendix' in white, bold, sans-serif font. The background of the slide features a complex, glowing blue circuit board pattern with various traces and components.

# Appendix

	BW3000	BW3700
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎顧客要求に応えるフレキシブルな構成（洗浄槽の配列、数量を任意に対応可能）</li> <li>◎生産効率の向上</li> <li>◎500WPHに対応する高速LD/ULD</li> <li>◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能</li> <li>◎二酸化炭素の低減</li> <li>◎気体流量のコントロールを実現</li> <li>◎標準化仕様化を進め、立上タイム短縮</li> <li>◎SEMI standardに対応</li> <li>◎EES（EDA or TDI）に対応</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能</li> <li>◎排気システムの個別配管により各処理槽の処理能力を安定化</li> <li>◎ウエハ間ピッチ7mm処理の実現</li> <li>◎ウエハの接触部の縮小化の実現によるパーティクル（微細なゴミ）の発生を減少</li> <li>◎気泡発生の低減化を実現</li> <li>◎リバースフローシステムにより液置換効率を向上</li> <li>◎濃度の安定性を向上</li> <li>◎豊富な処理槽種類に対応</li> <li>◎1薬液プラス1DIW構成に対応</li> </ul>
価格帯 (平均単価) (百万円)	210~400	320~560

	BW2000	HTS-300
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 200mmウエハ対応	枚葉式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 高い生産効率</li> <li>◎ 高い洗浄能力</li> <li>◎ 省フットプリント</li> <li>◎ 顧客要求に応えるフレキシブルな構成（処理槽の構成、数量の変更に対応）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 最小150ccの薬液消費量での処理を実現</li> <li>◎ 最高240℃での高温処理を実現</li> <li>◎ 最短30秒でのストリップ処理を実現</li> <li>◎ ウエハ反転処理によるヒューム（薬液の蒸気）拡散防止の実現</li> </ul>
価格帯 (平均単価) (百万円)	150～210	330～540



## 本資料の取扱上の注意

- 本資料は、2024年2月9日発表の決算短信に基づいて作成されています。
- また、本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度などの変化により、大きく見通しの変動する可能性があります。
- 本資料に記載しております数字につきましては、単位未満切り捨てで処理しております。また、比率は四捨五入しております。

## 本資料に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイ・イー・ティ  
経営統括本部

TEL 0865-69-4281